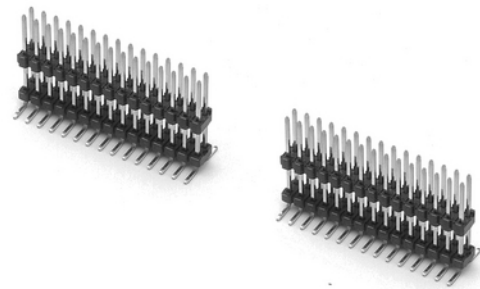


## SMT-Sandwich-Stiftleisten RM 2,00mm, 1-/2-reihig SMT Dual Body Pin Headers, 2.00mm Pitch, Single/Double Row

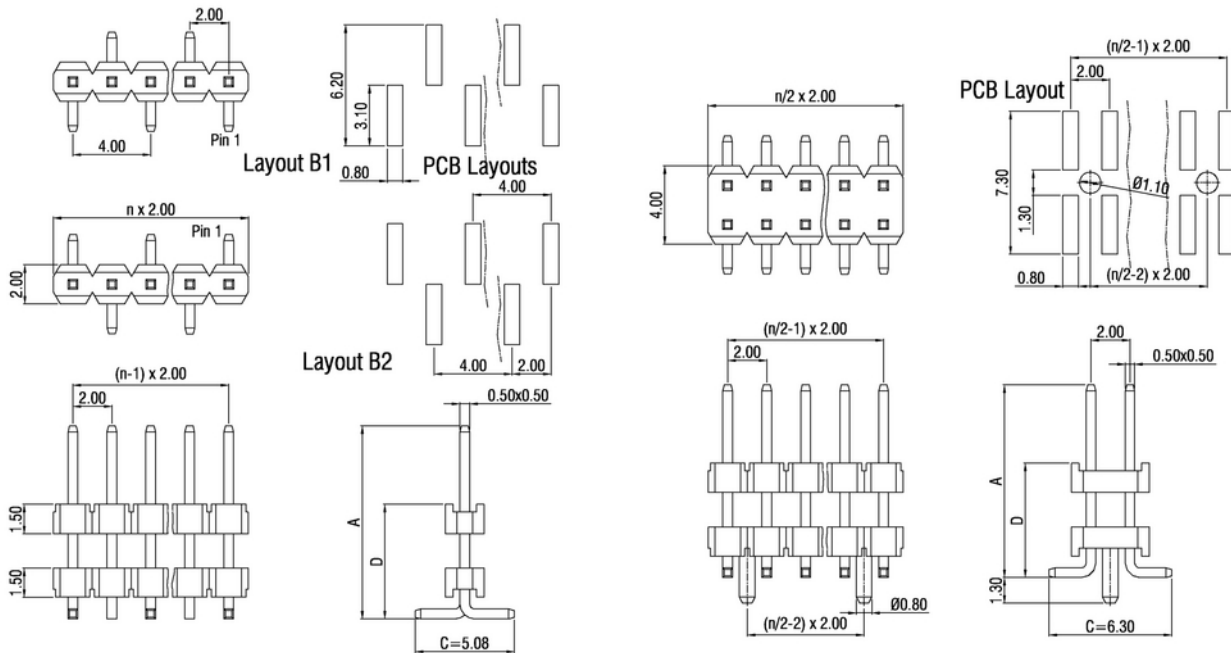
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung <i>0.50mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>DC</sub> <i>1kV<sub>DC</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V <sub>AC</sub> <i>250V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +125°C <i>-40°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Mate with Female Headers:*  
**7450 7451 4160 6192** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



Series	Contacts*	Rows*	Dimensions*	Dim.*	Plating*	Loc. Pegs*	Packaging*
<b>7352</b>	<b>80</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>6,35</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>ST</b>
	03-40 Einreihig <i>Single row</i>	11 Layout B1 12 Layout B2	01 A=10,70mm 02 A=7,85mm 03 A=11,86mm 04 A=12,37mm 05 A=15,37mm 06 A=17,35mm 07 A=9,86mm 99 Kundenspez. <i>Customer-spec.</i>	D [in mm]	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Duplex plating</i>	00 Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i> 10 Mit Pos.hilfen <i>(nur 2-reihig)</i> With loc. pegs <i>(double row only)</i>	ST PPST PPTR
	04-80 2-reihig <i>Double row</i>	20 Zweireihig <i>Double row</i>					

**Lieferformen / Packaging Options:**  
**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pad / *In tubes w/o Pick&Place-Pad*  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pad / *In tubes with P&P-Pad*  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pad / *Tape & Reel with P&P-Pad*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
 FAX +49 5223 98507-50

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

